

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載!

## 貴金属メッキ方法と工程

\*\*\*\*\*

[登録・公開編]平成20年(1年間) 78点

(税込価格)

(本体価格)

全文PDF	CD-ROM版(抄録版付)	¥27,090-	¥25,800-
全文紙収録	B5製本版	¥27,090-	¥25,800-
(CD-ROM版・B5製本版 一括購入)		¥39,900-	¥38,000-

### 既刊関連セットのご案内

(本体価格)

No.	登録・公開	既刊関連セットのご案内	点	本体価格
No,10157	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.19	88点 ¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点 ¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点 ¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点 ¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点 ¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点 ¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点 ¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点 ¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点 ¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点 ¥27,000
No,8350	"	"	平.9	74点 ¥26,700
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点 ¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点 ¥25,300
No,7796	"	"	平.6	69点 ¥24,800
No,7672	"	"	平.5	64点 ¥23,700
No,7520	"	"	平.4	69点 ¥24,700
No,7299	"	"	平.3	66点 ¥23,000
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点 ¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点 ¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点 ¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点 ¥26,800
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点 ¥23,200

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
所 属 部 署	ニュースガイド No. <span style="float: right;">CD-ROM版・B5製本版・一括購入</span>
担 当 者 名	題 名 <span style="float: right;">合計 ¥</span>
	E-mail <span style="float: right;">( ) FAX ( )</span>
住所 〒	

# 貴金属メッキの方法と工程 No.10293

[登録・公開編] 平成20年(1年間) 78点

CD-ROM版 ¥27,090 B5製本版 ¥27,090 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥39,900 )

- |  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| めっき装置、めっき液評価装置、めっき液の運用方法及びめっき液の評価方法                  | 三菱電機株式会社                               | 銀膜、銀膜の製造方法、LED実装用基板、及びLED実装用基板の製造方法                    | 松下電工株式会社                            |
| 2 表面処理方法及び接点部材                                       | 株式会社エルグ                                | 31 ウェハーめっき方法   | ロム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー |
| 3 金属セラミック複合部材に対するメッキ方法、パターン製造方法、および湿式処理装置、並びにパワーモ... | DOWAメタルテック株式会社                         | 32 スパークプラグ用の貴金属合金チップ及びその製造方法                           | 田中貴金属工業株式会社                         |
| 4 半導体装置の製造方法   | NECエレクトロニクス株式会社                        | 33 光透過性電磁波シールド材の製造方法、光透過性電磁波シールド材、およびディスプレイ用フィルタ       | 株式会社ブリヂストン                          |
| 5 カップ式めっき装置  | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社             | 34 硬質金合金めっき液   | ロム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー |
| 6 半導体基板の電気化学的処理方法                                    | マイクロン テクノロジー、インク                       | 35 金属セラミック複合部材に対するメッキ方法、パターン製造方法、および湿式処理装置、並びにパワーモジ... | DOWAホールディングス株式会社                    |
| 7 白色被膜を有する装飾品およびその製造方法                               | シチズンホールディングス株式会社                       | 36 めっき終端および電解めっきを使用する形成方法                              | エイブイエックス コーポレーション                   |
| 8 半導体装置の製造方法   | 株式会社東芝                                 | 37 めっき方法   | ロム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー |
| 9 表面処理方法、電子部品の製造方法、およびコネクタピン等の製造方法                   | 大和電機工業株式会社                             | 38 水素透過膜構造体の製造方法                                       | 奥野製薬工業株式会社                          |
| 10 コーティング膜、コーティング膜で被覆された物品及び耐食性コーティング方法              | ダイキン工業株式会社                             | 39 金属表面処理剤及び金属層の表面処理方法                                 | 有限会社ケミカル電子                          |
| 11 合成物質電気メッキ用基板の活性化方法                                | エンソー インコーポレイテッド                        | 40 磁性膜の製造方法及び磁性膜                                       | TDK株式会社                             |
| 12 金めっき部品用洗浄剤およびすすぎ剤並びに洗浄方法及びすすぎ方法                   | 荒川化学工業株式会社                             | 41 パラジウム合金めっき液及びそのめっき液を用いためっき方法                        | 田中貴金属工業株式会社                         |
| 13 電解金めっき液及び金めっき方法                                   | エヌ・イーケムキャット株式会社                        | 42 貴金属めっきを施したチタン又はチタン合金材料                              | 日鉱金属株式会社                            |
| 14 電気・電子回路部品   | 株式会社大和化成研究所                            | 43 複合めっき材およびその製造方法                                     | 国立大学法人 熊本大学                         |
| 15 銀電気めっき浴   | エヌ・イーケムキャット株式会社                        | 44 銀めっき金属部材およびその製造方法                                   | DOWAホールディングス株式会社                    |
| 16 ボンディングワイヤー及びその製造方法                                | 古河電気工業株式会社                             | 45 イリジウム・コバルト合金めっき液                                    | 日進化成株式会社                            |
| 17 シアン化物非含有銀系メッキ浴、メッキ体及びメッキ方法                        | 石原薬品株式会社                               | 46 めっき方法   | 日進化成株式会社                            |
| 18 熔融塩電解装置   | 田中貴金属工業株式会社                            | 47 被覆タービンエンジン部品及びその製造方法                                | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー                  |
| 19 熔融塩電解方法   | 田中貴金属工業株式会社                            | 48 基板処理装置及び基板処理方法                                      | 株式会社荏原製作所                           |
| 20 メッキ表面の後処理方法                                       | 石原薬品株式会社                               | 49 導電性微粒子、基板構成体及び微粒子のめっき方法                             | 積水化学工業株式会社                          |
| 21 メッキ表面の後処理方法                                       | 石原薬品株式会社                               | 50 金バンブ又は金配線形成用非シアン系電解金めっき浴                            | エヌ・イーケムキャット株式会社                     |
| 22 コンタクトの製造方法  | 日本航空電子工業株式会社                           | 51 バンブ形成用非シアン系電解金めっき浴                                  | エヌ・イーケムキャット株式会社                     |
| 23 金および金合金の電着浴とその用法                                  | ソニーエレクトロニクス・テクノロジー・ゲーエムベーハー ウント コーハーゲー | 52 複合めっき材の製造方法   | DOWAメタルテック株式会社                      |
| 24 金メッキ液および金メッキ方法                                    | 三菱化学株式会社                               | 53 塩素発生用電極   | 田中貴金属工業株式会社                         |
| 25 電解技術を用いて、金属ゲルマニウムの薄膜を形成する方法                       | 株式会社プライマリー                             | 54 表面増強振動分光分析用治具及びその製造方法                               | キヤノン株式会社                            |
| 26 電析法によるコバルト - 白金合金磁性膜の製造方法                         | ロム・アンド・ハース・エレクトロニック・エンジニアーズ株式会社        | 55 金 - 銀合金めっき液   | エヌ・イーケムキャット株式会社                     |
| 27 めっき方法およびマイクロデバイスの製造方法                             | TDK株式会社                                | 56 半導体装置の製造方法  | NECエレクトロニクス株式会社                     |
| 28 金属線材メッキ用不溶性陽極及びそれをを用いた金属線材メッキ方法                   | ダイソー株式会社                               | 57 めっき装置及びめっき方法  | 株式会社荏原製作所                           |
| 29 めっき方法およびマイクロデバイスの製造方法                             | TDK株式会社                                |  |                                     |

以下21点省略